# 銅張誘電体基板に挟まれた誘電体円柱共振器を用いた 界面比導電率評価の高精度化

C-2 Accuracy improvement of the interface conductivity evaluation

(2)

using a dielectric rod resonator sandwiched between copper-clad dielectric substrates

平野勇作 清水隆志 古神義則

Yusaku Hirano Takashi Shimizu Yoshinori Kogami

宇都宮大学大学院工学研究科

Utsunomiya University, Graduate School of Engineering

## 1. はじめに

図1に示す銅張誘電体基板に挟まれた誘電体円柱共振 器を用いた界面比導電率評価に関する検討を行っている [1]。誘電体円柱等の複素誘電率は別途測定しておく必要 がある。その測定周波数が界面比導電率の測定周波数と 異なる場合、誘電体円柱の誘電正接の周波数依存性が、 界面比導電率の測定結果に影響を与える[2]。本報告では、 誘電体円柱の誘電正接を補正した界面比導電率評価法を 報告する。

## 2. 測定原理

銅張誘電体基板に挟まれた誘電体円柱共振器の断面構造を図1に示す。この構造では、基板が厚くなると共振 周波数は低下する。界面比導電率  $\sigma_{rb}$ は共振周波数  $f_0$  およ び無負荷  $QQ_u$ の測定値より、次式で求められる[1]。

$$\sigma_{rb} = \frac{A^2}{\pi\mu_0 f_0^3 \sigma_0} \left[ \frac{1}{Q_u} + \frac{2}{f_0} \{ B\varepsilon_r \tan \delta @f_0 + C\varepsilon_{rs} \tan \delta_s \} \right]^{-2}$$
(1)

ただし、真空の透磁率 $\mu_0$ 、万国標準軟銅の導電率 $\sigma_0$ 、摂動 計算により求められる係数 A, B, C である。また、測定周波 数における誘電正接  $\tan \delta \Theta f_0$  は、次式により求められる。

ただし、誘電正接の周波数依存性より得られる近似直線の 傾き X である。

## 3. 誘電体円柱の誘電正接の周波数依存性

測定に使用する(ZrSn)TiO4 円柱、Ba(MgTa)O3 円柱、サ ファイア円柱の誘電正接の周波数依存性を図2に示す。た だし、測定は2誘電体円柱共振器法[3]により行った。周波 数依存性の近似式は図2中に示す。図2より、(ZrSn)TiO4 円柱は周波数依存性が特に強いことがわかる。

## 4. 誘電体円柱の誘電正接の補正の適用

事前に比導電率を評価した銅箔に、厚みの異なる誘電 体基板を貼り付けて銅張誘電体基板を模擬し、測定試料と した。そのため、界面比導電率の評価結果は基板厚みによ らず一定となる。補正の有無による界面比導電率の比較を 図3に示す。誘電正接の周波数依存性が強い(ZrSn)TiO4 円柱を用いた3,10GHz帯の測定結果では、事前測定した 銅箔表面の比導電率に近づく結果が得られている。また、 サファイア円柱を用いた7GHz帯の測定結果では、補正の 影響は小さいことがわかる。また、周波数が高くなると、基 板厚さの増加により界面比導電率の評価結果は低下する。 この要因として、放射による無負荷Qの低下が考えられ、さ らなる検討が必要である。

## 5. まとめ

誘電体円柱の誘電正接を補正した界面比導電率評価 法を提案し、その有効性を確認した。



図1 銅張誘電体基板に挟まれた誘電体円柱共振器



図2 誘電体円柱の誘電正接の周波数依存性



図3 補正の有無による界面比導電率の比較

<参考文献>

- 清水、二階堂、古神、"銅張誘電体基板に挟まれた誘電体円 柱共振器の共振特性解析、"信学技報、vol. 115, no. 115, MW2015-44, pp.35-40, June 2015.
- [2] 平野, 清水, 古神, "銅張誘電体基板に挟まれた誘電体円柱 共振器を用いた界面比導電率の周波数依存性測定に関す る検討, "信学技報, Mar. 2018.
- [3] Y. Kobayashi, M. Kato, "Mocrowave measurement of dielectric properties of low-loss materials by the dielectric rod resonator method, "*IEEE Trans. Microw. Theory Tech.*, vol. 33, no. 9, pp. 586-592, Jul. 1985.